# 電子プローブマイクロアナライザーを用いたレジンマトリックス内 グラファイト分散状態評価

# 三重大学工学部工学研究科技術部

#### 中村昇二

# Email shoji@mach.mie-u.ac.jp

# 1. はじめに

昨年,著者が管理する電子プローブマイクロア ナライザー(以下,EPMAという)のユーザーから 面分析方法の相談が持ち込まれた.サンプルは, マトリックスを樹脂として,添加材にグラファイ ト粉末を用いたいわゆる複合材であり化学的組 成は共にカーボンである.

初見で、本サンプルが互いにカーボンというこ とから一般的には不可能と判断したが、ユーザー およびメーカーからの情報等を基に未経験の面 分析に向け数々の試行をおこなった.

試行錯誤を繰り返す中,ある一つの分析結果に たどりついたのでここに記し,様々な方からのご 意見・ご提案を頂きたく本報告をおこなう.

# 2. EPMAとは

EPMA とは、電子銃から発生した電子線が加速さ れて、収束レンズ・対物レンズを通過し微小な大 きさに絞られ試料に照射する装置である.具体的 には、絞られたビームを試料表面に照射すること によりビームと試料との相互作用から発生する 透過電子・反射電子・吸収電子・二次電子・オー ジェ電子とX線(特性X線)を用いて微小分析を おこない各種元素における定性・定量分析、線・ 面分析等をおこなうものである<sup>1)</sup>.本装置(JEOL 製JXA8900R)の構成を写真1に示す.



Photo. 1 EPMA (JXA8900R by JEOL)

3. サンプルおよび目的

今回依頼者側から持ち込まれたサンプルは,カ ーボン製樹脂とカーボングラファイト粉末から なる複合材である.分析目的は成形体作製プロセ スおよび出発材料等からくる添加剤グラファイ ト粉末の分散を確認・評価するのが主な目的とし ている.各材料の詳細な材料組成および成形過程 は研究上守秘の関係から公表は差し控える.今回 EPMA 分析に供された成形体サンプルを写真2に 示す.

EPMA 試料として不可分の電気導通性は, マトリ ックスとして用いられる樹脂そのものには無く, 添加されるグラファイト粉末には存在する.従っ て,樹脂だけを分析しようとする場合は,金コー ティングを施す必要があり,複合材となった成形 体においてはその必要は無いことになる.



Photo.2 Sample of Carbon composite

# 4. EPMA 面分析

#### 4-1波高分析器からの試み

面分析を行うにあたり,一般的にまず行うこと は成形体を構成する2種類の元素の波形解析か らである.本サンプルは,共にカーボンであるこ とから両者を分離できるような際立った波形形 状の違いはなかった.図1に樹脂およびグラファ イト粉末の各波形を重ね合わせたものを示す.



Fig.1 Profile of resin and graphite

図から,各波形共に 4.43nm をピークに低波長 側に肩構造を有する非対称形状であることが分 かる.C-Kα特性 X 線の測定条件は,分光結晶: LDE2(超格子 X 線分光素子,2d=9.5-10.5nm) 加 速電圧:15kV 照射電流:30nA プローブ径:10 μm とし,樹脂測定に際しては導通性がないこと から 2nm の金イオンコーティング処理を施した.

上記の結果から,最初のアプローチとして WDS (波長分散型 X 線分光器)で波長分光できないと し,これらが重畳したときに利用される波高分析 器を用いた分析を行った.波高分析器は,X 線測 定系の比例増幅器と計数系・計数率系の中間に配 置され,分光器で分光分離できない X 線波形を, そのエネルギー差を利用して分離・選別する装置 である<sup>2)</sup>.図2,3に樹脂およびグラファイト粉 末の C-Kαの波高分布曲線を示す.当初,波形の ピークカウントが低いことから照射電流・時間等 を数えおとしの発生を考慮しつつ適正な条件を 探っていった.



Fig. 2 Wave-height distributions profile of resin



Fig. 3 Wave-height distributions profile of graphite-powder

しかし,図2,3で示された両波高分布曲線からは,二元素を分離・選別できるほどの顕著な差は現れなかった.

# 4-2 波形特性からの試み

# 4-2-1コーティング及び走査

一般的に面分析を行う場合, 倍率 1000 程度ま ではビームスキャン方式を用いて試料面上を走 査し, それ以上の高倍率では両端に特性 X 線の強 度差が生じることからステージスキャン方式を 用いることになっている<sup>3)</sup>.しかし, 今回基礎デ ータをとるために行った樹脂のみの分析におい て特異な現象が現れ,本テーマとは直接関係は無 いが以下に報告する.

樹脂の分析ということで、電気導通性を得るた めの方法としては、カーボン蒸着の使用は樹脂組 成と同じことから不適であり、金イオンスパッタ コーティングを用いた.加速電圧 15kV,照射電流 30nA,コーティング膜 1nm で行い、結果の面分析 は右側(プローブ進行方向)に進むに従い計数率 (CPS)が増加する傾向が現れた.これを回避す るため、コーティング膜を厚くする試みをおこな ったが結果は改善されず、また照射電流値を一桁 下げておこなったが回避されなかった.最後に倍 率 2000 にして行うことをメーカー側に提案され 実行したが計数率の強度差は解消されなかった. 図4に倍率 1000,図5に倍率 2000 で試行した各 面分析結果を示す.



Fig. 4 Resin Mapping by Several Au covered (Mag1000)



図4,5から,ビームスキャン走査による何ら かの特異な帯電等の影響があり適正な分析は不 可と考え,倍率1000 でのステージスキャンで試 みた結果,左右の計数率強度差は改善された.図 6に前記ビームスキャンと同条件で行い改善さ れたステージスキャン (D-well 50msec, Points 200×200, Interval 0.44 $\mu$ m)の面分析結果を示 す.なお,図4,6におけるプロファイルは線分 析結果であり,直線は分析位置を示し波形線は計 数率を表している.

# 4-2-2 面分析の試み

4-2-1での結果を踏まえ,実際にステージス キャンによるグラファイトを充填した成形体の カーボン面分析を試みた.面分析の条件である分 光結晶位置は,図1から得られたピークから 4.47nmに固定し分析をおこなった.図7に低充填 成形体の表面形状のSEM像および研磨等の表面処 理を施さない状態でのカーボン面分析を示す.図 から,理想どおりの分散があり適当かと判断した が,確認のため EPMA 試料としての基本条件であ るフラット面(鏡面)での分析も試みた.図8に アルミナ粉末での研磨および市販のカッターナ イフで鋭利に仕上げた各面の面分析を示す.

図8から,計数率が高く赤色に表現されている グラファイトと思われる部分が,研磨面からカッ ター面になり表面がよりフラットになるにつれ て赤色の部分が増えているのが分かる.特に象徴 的なのは,図8右に見られる左斜め上部分と下部 分との差である.これは,丁度ナイフのカット面 が斜めにはいり,アルミナ研磨との境界になる.

これらから,成形直後の表面の僅かな凸凹でも

計数率に敏感に影響することが再確認された.



Fig.6 Stage-scan Mapping



No Polishing

Fig.7 Mapping of Surface process



Alumina polishing

SEM Image



Cutter-knifed

Fig.8 Mapping of Surface process

SEM image



Mapping image





Normal mode modify

High mode modify

— 10μm

Fig.10 Modify Mapping Image



Fig.11 Modify Mapping Image for both ends

#### 5. 分析結果

前記した数々の試行錯誤を繰り返し,一つの条件を提案し面分析を行った.分光結晶位置固定, ステージスキャンおよびカッターナイフ切削面 等の各条件をクリアし行うこととした.図9にサ ンプル断面の面分析箇所の SEM 像および面分析 を示す.両図の比較から,赤い箇所にグラファイ トが存在しているように想像できる.

ここで、本体 EPMA のアプリケーションソフ トである Image Modify を使用する試みをおこ なった.本ソフトは、図1のプロファイルでの計 数率・約300CPS をグラファイト、同じく約150CPS をマトリックスである樹脂層と判断し、図9の生 データから樹脂に相当する箇所を任意に消去修 正するものである.図10に画像処理後の面分析 を示し、図11にサンプル断面の両端の面分析を 示す.分析図10左の閾値は150CPS とし右は同 170CPS とした.図から、サンプル断面の上層部に 比較的多くのグラファイト分散があるのではな いかとの評価が可能であり、またサンプル作製工 程から考察すると妥当な分散であるかと思われ る.

しかし、これに関しては結果の裏付のためのサ ンプルとして、よりグラファイト充填率の少ない もの、また任意にある局所だけ充填させたサンプ ルを用いて複数分析することが必要不可である と考える.また、グラファイト分散時の配向(垂 直・平面)からくる特性 X 線強度差の考慮も必要 となる.

# 6. おわりに

ユーザーから依頼された直後は、カーボンマト

リックス内の同元素カーボンの面分析というこ とで、不可能な依頼分析と高を括りつつのスター トであった.その後、様々な文献等の情報および メーカーからのアドバイスを頂くことにより、少 しは寄り道をしたものの最終的には裏づけデー タは要るがグラファイト分散評価への入口まで はたどりついたように思う.本技術研究会当日の 発表において、著者よりも EPMA 経験の豊かな方々 からのご指摘、ご提案等を頂きより信憑性の高い 高度な分析結果を創造したいと願っている.

今後の課題として、本分析において直接に有効 とはならかった波高分析であるが、同元素の分 離・重畳等の回避に利用可能であることから波高 分布曲線のデータの蓄積が必要と考える.波高分 布曲線のデータベースは、メーカーには存在する が公開はしていない現状である.理由として、プ ロファイルは各々ユーザーが使用する波高分析 装置の要素が起因するからである.従って、装置 毎の元素プロファイルが必要であることから、三 重大学においても本装置での各元素波高分析プ ロファイルを作成していきたい.

最後に、本 EPMA 装置が設置されている創造開 発研究センターの平成17年度予算にて、EPMA シ ステムの更新(ワークステーション含む)が認め られ、より最新の機能を備えたものに生まれ変わ った.大学の技術職員として、今後もより技術の 研鑽をおこない分析技術の向上を目指すととも に、機器のメンテナンスにも尽力し機器性能の維 持に努めユーザーの希望に応えたいと思う.

- 7. 参考文献
- [1] 電子プローブマイクロアナライザー型録日本電子(株) 1994
- [2] JEOLE EPMA・表面分析ユーザーズミーティン グ資料「EPMA における波高分析器とその利用
  法」 日本電子 1984
- [3] 電子プローブマイクロアナライザー 日本 表面学会編 丸善(株) 1998